



意法半導體公布 2024 年第二季財報

- 第二季淨營收 32.3 億美元；毛利率 40.1%；營業利潤率 11.6%，淨利潤 3.53 億美元
- 上半年淨營收 67.0 億美元；毛利率 40.9 %；營業利潤率 13.8%，淨利潤 8.65 億美元
- 業務展望（中位數）：第三季淨營收 32.5 億美元；毛利率 38%

【臺北訊，2024年7月29日】— 服務橫跨多重電子應用領域的全球半導體領導廠商意法半導體（STMicroelectronics，簡稱 ST；紐約證券交易所代碼：STM）公布依照美國通用會計準則（U.S. GAAP）編制之截至2024年6月29日的第二季財報。

意法半導體第二季淨營收達32.3億美元，毛利率40.1%。營業利潤率11.6%，淨利潤為3.53億美元，稀釋每股盈餘38美分。

意法半導體總裁暨執行長Jean-Marc Chery表示，「第二季淨營收高於業務預期的中位數，雖然個人電子產品營收上揚，但車用產品營收卻低於預期，抵消了部分漲幅，而毛利率符合預期。受微控制器子產品部與功率及離散元件子產品部營收下滑之影響，上半年淨營收較上年衰退21.9%。營業利潤率為13.8%，而淨利潤則為8.65億美元。本季與之前預期相反，工業客戶訂單情況並未轉暖，同時車用產品需求亦不振。第三季業務展望（中位數）淨營收預計32.5億美元，較去年萎縮26.7%，但較上季微幅增加0.6%；毛利率預計約38%，包含閒置產能支出增加350個基點之影響。ST將推動2024全年營收132至137億美元計畫。依照此一計畫，預計毛利率將約40%。」

2024年第二季財報重點

美國通用會計準則 (單位：百萬美元，每股收益指標除外)	2024年 第二季	2024年 第一季	2023年 第二季	Q/Q	Y/Y
淨營收	\$3,232	\$3,465	\$4,326	-6.7%	-25.3%
毛利潤	\$1,296	\$1,444	\$2,119	-10.2%	-38.9%
毛利率	40.1%	41.7%	49.0%	-160 bps	-890 bps
營業利潤	\$375	\$551	\$1,146	-32.0%	-67.3%
營業利潤率	11.6%	15.9%	26.5%	-430 bps	-1,490 bps
淨利潤	\$353	\$513	\$1,001	-31.2%	-64.8%
稀釋每股盈餘	\$0.38	\$0.54	\$1.06	-29.6%	-64.2%

2024年第二季回顧

註：2024 年 1 月 10 日，意法半導體宣布新的組織，因此自2024年第一季起各產品部財務報告將有所變更。前期比較資訊已經做了對應調整。詳見附件資訊。

各產品部門淨營收 (單位：百萬美元)	2024年 第二季	2024年 第一季	2023年 第二季	Q/Q	Y/Y
-----------------------	--------------	--------------	--------------	-----	-----

類比、MEMS與感測器子產品部 (AM&S)	1,165	1,217	1,293	-4.3%	-10.0%
功率與離散元件子產品部 (P&D)	747	820	989	-8.8%	-24.4%
類比、功率與離散元件、MEMS與感測器產品部 (APMS) 營收小計	1,912	2,037	2,282	-6.1%	-16.2%
微控制器子產品部 (MCU)	800	950	1,482	-15.7%	-46.0%
數位IC與射頻子產品部 (D&RF)	516	475	558	8.6%	-7.6%
微控制器、數位IC與射頻產品部 (MDRF) 營收合計	1,316	1,425	2,040	-7.6%	-35.5%
其他	4	3	4	-	-
淨營收總計	3,232	3,465	4,326	-6.7%	-25.3%

2024年第二季淨營收總計32.3億美元，較上年萎縮25.3%。OEM和代理商的淨銷售營收相較去年分別減少14.9%和43.7%。若較上季，淨營收則衰退6.7%，比預測中位數高90個基點。

第二季毛利潤總計13億美元，較上年減少38.9%。毛利率為40.1%，與意法半導體業績指引預測的中值一致，若與去年同期相比，則下降890個基點，主要原因乃受產品結構和銷售價格的綜合影響，以及閒置產能支出增加所導致。

第二季營業利潤達3.75億美元，而去年同期則為11.5億美元，降幅達67.3%。營業利潤率（佔淨營收）11.6%，比2023年第二季的26.5%下降了1,490個基點。

相較去年同期各產品部門之表現：

類比、功率與離散元件、MEMS與感測器產品部 (APMS)：

類比、MEMS與感測器子產品部 (AM&S)

- 營收衰退 10.0%，主要受影像業務下跌之影響。
- 營業利潤 1.44 億美元，降幅為 44.5%。營業利潤率則 12.4%，去年同期則為 20.0%。

功率與離散 (P&D) 子產品部：

- 營收減少 24.4%。
- 營業利潤 1.10 億美元，降幅達 57.9%。營業利潤率為 14.7%，去年同期則為 26.4%。

微控制器、數位IC與射頻產品部 (MDRF)：

微控制器子產品部 (MCU)

- 營收萎縮 46.0%，主要受通用微控制器業務下滑之影響。
- 營業利潤為 7,200 萬美元，降幅 87.1%。營業利潤率為 8.9%，去年同期則為 37.2%。

數位IC和射頻子產品部 (D&RF)：

- 雖然射頻業務有所成長，但受 ADAS 業務下滑影響，整體營收降低 7.6%。
- 營業利潤為 1.5 億美元，萎縮 23.8%。營業利潤率為 29.1%，去年同期則為 35.2%。

淨利潤和稀釋每股盈餘分別降至3.53億美元和38美分，而去年同期則分別為10.0億美元和1.06美元。

現金流和資產負債表摘要

(單位：百萬美元)	12 個月					
	2024 年 第二季	2024 年 第一季	2023 年 第二季	2024 年 第二季	2023 年 第二季	過去 12 個月數據 變化
營業活動產生的現金淨額	702	859	1,311	4,922	5,832	-15.6%
自由現金流 (非美國通用會計準則) ¹	159	(134)	209	1,384	1,694	-18.3%

2024 年第二季營運產生之現金淨額為 7.02 億美元，而去年同期則為 13.1 億美元。

第二季淨資本支出 (非美國通用會計準則) 為 5.28 億美元，而去年同期則為 10.7 億美元。

第二季自由現金流 (非美國通用會計準則) 為 1.59 億美元，去年同期則為 2.09 億美元。

2024 年第二季末庫存為 28.1 億美元，上季為 26.9 億美元，去年同期則為 30.5 億美元。季末庫存周轉天數 130 天，上季為 122 天，去年同期則為 126 天。

第二季支付現金股息 7,300 萬美元，回購 8,800 萬美元公司股票，完成了 2021 年 7 月 1 日公布之 10.40 億美元股票回購計畫。2024 年 6 月 21 日，公司將啟動新的股票回購計畫，並準備在 3 年內回購 11.0 億美元公司股票，該計畫由兩個子計畫組成。

意法半導體的淨財務狀況 (非美國通用會計原則)，截至 2024 年 6 月 29 日為 32.0 億美元；截止 2024 年 3 月 30 日則為 31.3 億美元。流動資產總計 62.9 億美元，負債總計 30.9 億美元。考量到尚未發生支出的專案撥款預付款項對流動資產總額之影響，調整後的淨財務狀況為 28 億美元。

業務展望

公司 2024 年第三季營收指引中位數：

- 淨營收預計將達 32.5 億美元，較上季提升約 0.6%，上下浮動 350 個基點；
- 毛利率約 38%，上下浮動 200 個基點；
- 本業務展望假設 2024 年第三季美元兌歐元匯率約 1.07 美元 = 1.00 歐元，包括當前套期保值合約之影響；
- 第三季關帳日為 2024 年 9 月 28 日。

非美國公認會計原則的財務補充資訊使用須知

本新聞稿包含非美國公認會計準則財務補充資訊。

請注意，這些財務指標未經審核，亦非根據美國通用會計原則編制，因此，不可替代美國通用會計原則財務指標。此外，不得使用非美國通用會計準則財務指標與其他公司之類似資訊進行比較。為彌補這些限制影響，不應孤立地閱讀非美國通用會計原則的財務補充資訊，而應結合意法半導體根據美國通用會計原則編制的合併財務報表。

欲瞭解意法半導體非美國通用會計準則財務指標，以及其對應的美國通用會計準則財務指標調整表，請參閱本新聞稿附件。

¹ 有關非美國通用會計準則如何轉換成美國 GAAP 資訊，以及 ST 認為這些評估指標之重要理由，請參考附件。

前瞻聲明

本新聞稿中包含一些非歷史事實之敘述是以管理階層當前的觀點和假設，以已知和未知風險和不確定性為前提，對未來做出涉及已知和未知的風險、不確定趨勢的預測陳述，以及其他前瞻性陳述（依照1933年證券法最新版第27A條或1934年證券交易法最新版第21E條之規定），這些風險和不確定趨勢可能由於以下因素而導致實際結果、業績或事件與本聲明所預期的結果、業績或事件存在重大差異：

- 全球貿易政策的變化，包括關稅和貿易壁壘的採用和擴大，可能會影響宏觀經濟環境並對本公司產品需求產生不利影響；
- 不確定的宏觀經濟和產業趨勢（例如，通貨膨脹和供應鏈波動），可能會影響本公司產能和終端市場對產品的需求；
- 客戶需求與預測不同；
- 在瞬息萬變的技術環境中設計、製造和銷售創新產品的能力；
- 本公司、客戶或供應商經營所在地區之經濟、社會、公共衛生、勞工、政治或基礎建設條件的變化，包括由於宏觀經濟或地區事件、地緣政治和軍事衝突、社會動盪、勞工行動或恐怖活動；
- 本公司任何主要代理商出現財務困難或主要客戶大幅減少訂單；
- 本公司產能利用率、產品組合和製造效率和／或滿足供應商或協力廠商製造供應商預留之產能所需的產量；
- 本公司運營所需設備、原物料、公用事業服務、協力廠商製造服務和技術或其他物資供應狀況和成本（包括通貨膨脹導致成本增加）；
- 本公司系統的功能和性能：這些系統面臨網路安全威脅，並支援本公司之製造、財務、銷售等重要營運活動；入侵本公司或客戶、供應商、合作夥伴、協力廠商授權技術提供商的IT系統；
- 本公司之員工、客戶或其他協力廠商的個人資料被竊取、丟失或非法使用，以及違反隱私法規；
- 本公司競爭對手或其他協力廠商智慧財產權（IP）主張的影響，以及本公司能否以合理的條款和條件獲得所需技術許可；
- 稅收規則的變化、新的或修訂的立法、稅務審核的結果或國際稅務條約的變化可能影響本公司業績以及準確預估稅收抵免、退稅、減稅和準備金，以及實現遞延所得稅資產的能力，致本公司整體稅務狀況發生變化；
- 外匯市場的變化，尤其是與歐元和本公司營運所用之其他主要貨幣對美元的匯率變化；
- 正在進行之訴訟的結果以及本公司可能成為被告的任何新訴訟的影響；
- 產品責任或保修索賠，因疫情或無法交貨的索賠，或與本公司產品相關的其他索賠，或客戶召回產品包含本公司的晶片
- 本公司、客戶或供應商營運所在地區的自然事件，如惡劣天氣、地震、海嘯、火山爆發或其他自然行為、氣候變化的影響、健康風險和傳染病或全球流行傳染病；
- 半導體產業監管和相關法規加緊，包括與氣候變化和永續發展相關的監管和倡議，以及本公司到2027年範圍一和範圍二排放和範圍三部分排放達成碳中和的目標；
- 傳染病或全球傳染病疫情可能會在長時間內繼續對全球經濟產生重大負面影響，也可能對本公司之業務和營運產生重大不利影響；
- 本公司之供應商、競爭對手和客戶之間的橫向和垂直整合導致的產業變化；
- 逐步推動新計畫的能力，能否成功可能受本公司無法控制的因素影響，包括協力廠商提供之重要元件的供貨能力和外包商的表現是否符合預期。

上述前瞻性陳述受各種風險和不確定性之影響，可能導致本公司業務的實際結果和業績與前瞻性陳述產生重大不利差異。某些前瞻性陳述可以透過使用前瞻性術語來辨識，例如「相信」、「預期」、「可能」、「應該」、「將」、「尋求」或類似表達或其否定形式或其他變體或類似術語，或透過對策略、計畫或意圖的討論。

其中一些風險已在「第3項」中定義並進行更詳細的論述。重要資訊——風險因素已列入本公司於2024年2月22日提交SEC證券會之截至2023年12月31日的年度Form 20-F年度報告中。如果其中一種或多種風險因素已成為既定事實或基本假設被證明是錯誤的，則實際結果可能會與本新聞稿中預期、相信或預期的結果大不相同。本公司不準備亦無義務更新本新聞稿

中的任何產業資訊或前瞻性陳述，反映後續事件或情況。

本公司在不定期報備證券交易委員會之「Item 3.重要資訊——風險因素」檔中列出上述不利變化或其他因素，這些因素可能對本公司之業務和／或財務狀況產生重大不利影響。

關於意法半導體

意法半導體匯聚超過 5 萬名半導體技術的創造者和製造者，掌握半導體供應鏈和先進的製造設備。做為一家整合元件製造商（IDM），意法半導體與逾 20 萬家客戶與數千個合作夥伴一起研發產品和解決方案，攜手建立生態系統，協助客戶因應挑戰和新機會，滿足世界對於永續發展之更高的需求。意法半導體的技術讓人們出行更智慧，電源和能源管理更高效，物聯網和連接技術的使用更廣泛。意法半導體致力於 2027 年達成碳中和（適用於範圍 1 和範圍 2，以及部分範圍 3）之目標。更多資訊，請瀏覽意法半導體官方網站：www.st.com。